

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-012

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	1、花旗银行电话会议调研（2019年8月12日） 2、招商证券牵头联合调研（2019年8月13日） 3、公司集中调研（2019年8月15日） 以上共计362人次。
时间	2019年8月12-15日
地点	公司南山总部5楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张丽君；财务部门总监：楼志勇；产品研发部总监：崔荣；证券事务代表：谢丹。
投资者关系活动主要内容介绍	环节： 问答交流 交流主要内容： Q1、请简要介绍2019年上半年公司经营业绩情况及业绩增长原因。 2019年上半年，公司实现营业收入47.92亿元，同比增长47.90%；印制电路板、封装基板、电子装联三项主营业务占公司整体营业收入比例分别为73.64%、10.45%、11.90%。其中，PCB业务实现主营业务收入35.28亿元，同比增长53.44%，收入增长主要来自通信、服务器等领域的需求拉动；封装基板业务实现主营业务收入5.01亿元，同比增长29.70%，主要受益于指纹类、射频模块类、存储类产品同比实现较快增长；PCBA业务实现主营业务收入5.70亿元，同比增长42.96%，业务增长主要来自通信领域产品的需求增加。

Q2、公司 PCB 业务下游领域占比情况如何？

公司生产的 PCB 产品主要面向通信、工控医疗、航空航天、汽车电子、服务器等企业级应用领域，其中通信领域为公司的核心市场领域。2019 年上半年，在 4G 持续扩容、5G 逐步发展的需求带动下，公司通信领域营收占比有一定提升；服务器领域营收同比有明显增加，但绝对值在总体营收中占比较少。其他领域如工控、医疗、航空航天、汽车电子等，分布相对分散。

Q3、与一季度相比，二季度 4G、5G 产品占比有怎样的变化？

从营收层面看，5G 产品二季度营收占比较一季度有所提升；4G 产品需求仍未出现明显下降趋势，与去年同期相比营收仍实现较好增长。

Q4、通信领域 PCB 产品主要存在哪些壁垒，公司有哪些相对优势？

首先是技术壁垒。通信领域 PCB 产品平均难度较高，产品技术从研发到实际应用在企业内部通常存在较长的演进过程，新厂商进入和积累技术需要一定时间。

随着 5G 时代临近，产品的复杂程度和集成化水平预计将进一步提升，PCB 产品运用特殊材料的比例也有所增加，因此会对生产厂商的技术成熟度和融合能力提出更高要求。公司进入通信领域时间较早，长期以来实施高研发投入，具备较深厚的技术积累。

其次是客户壁垒。下游客户尤其大型客户，对供应商通常有非常严格的资质认证制度，认证需要比较长的周期；为保证质量稳定可控，客户也倾向选择与已通过认证的 PCB 厂商保持长期规模化合作，新厂商进入存在一些障碍。公司拥有优质客户资源，与主要通信客户已有多年合作，能够深入了解客户产品需求、嵌入客户研发端，客户严格的认证制度也反哺公司内部管理水平提升。

Q5、业界所称的“埋铜块”技术，5G 通信板是否已经开始应用？

埋铜技术等在 3G 通信时代已经出现，在 4G 通信时代得到大规模应用。目前就 5G 通信而言，方案仍在不断调整和优化，不同客户的方案设计和技术应用也有所差异，较难一概而论。

Q6、5G 通信建设目前处于何种阶段？

参考市场上普遍判断,5G 通信目前整体仍处于前期建设阶段,无线基站建设比重较大,核心网、承载网等固网建设占比相对较小。

Q7、公司毛利率的变化主要来自哪些方面?

2019 年上半年,公司营业收入毛利率为 23.96%,同比增加 0.62%,增长主要来自于产品结构优化、运营效率提升和规模效益等因素。毛利率属于综合性指标,受到收入、成本、产品生命周期等多个方面影响。

Q8、公司封装基板同比实现较快增长,增长主要来自哪些产品,目前 MEMS-MIC 情况如何?

2019 年上半年,公司封装基板业务实现主营业务收入 5.01 亿元,同比增长 29.70%,主要受益于指纹类、射频模块类、存储类产品同比实现较快增长。公司基板主力产品 MEMS-MIC 上半年面临产品升级、技术难度大幅提升,公司在该类产品技术和产量上仍保持领先优势,当前占基板业务比例约为 30%-40%。其他产品占比相对分散。

Q9、无锡基板工厂预计什么时候可以达产?

公司 IPO 募投项目建设的无锡封装基板工厂已于 2019 年 6 月连线试生产,主要面向存储类封装基板产品,设计产能为 60 万平米。由于封装基板的工艺难度、技术门槛和客户要求更高,爬坡时间也通常较 PCB 工厂长。前期公司已经针对新基板厂的爬坡做了一些客户和能力上的准备,目前已有部分客户完成认证,关键客户开发进度符合预期。最终爬坡进度仍需参考实际情况。

Q10、公司南通数通二期项目目前进展情况如何?

南通数通二期是公司拟公开发行可转换债券募集资金投资建设的项目,由公司全资子公司南通深南电路有限公司实施,总投资为 12.45 亿元,其中拟以募集资金投入 10.64 亿元。该项目拟在南通深南原有土地上新建专业化工厂,对产品的生产工艺、生产流程进行优化,进一步提升生产流程的信息化和自动化程度,并提升产品工程设计水平以达到更高的材料利用率,主要产品为 5G 通信产品、服务器用高速高密度多层印制电路板。目前南通数通二期已投入建设。

Q11、公司可转债被证监会中止是否会影响南通数通二期项目的建设？目前可转债进度如何？

可转债暂时中止不影响南通数通二期项目的建设，目前公司已使用自有资金投入建设。公司已向中国证监会提交了恢复审查的申请。

Q12、公司南通一期工厂目前爬坡情况和营收贡献情况如何？

公司南通一期 PCB 工厂产能爬坡进度顺利，2019 年上半年南通一期工厂贡献营业收入约 5.05 亿元。

Q13、目前公司各个 PCB 工厂的产能利用率水平如何，产能是否可能成为营收增长的瓶颈？

当前公司共有 4 个 PCB 工厂在进行生产，其中深圳龙岗 2 个，无锡 1 个，南通 1 个，均处于产线比较饱满的状态，产能利用率维持在较高水平。此外还有南通数通二期 PCB 工厂在建。公司无锡 PCB 工厂于 2015 年起投入使用，南通 PCB 工厂 2018 年投入使用，期间 2016-2017 年公司产能无明显新增，但通过技术改造、产品结构调整等各方面措施仍实现了收入增长。

Q14、公司上半年的资本开支情况如何？

上半年公司的资本开支主要用于无锡基板工厂和南通数通二期工厂建设，以及各个存量工厂的技术改造。

Q15、当前全球形势下，公司是否有并购外延的考虑？

从公司角度看不排除并购的可能性，但也会综合各个方面考虑，首先从战略层面考虑是否与公司定位和未来发展方向相匹配，其次考虑能否与公司已有业务产生协同价值，不会贸然行动。公司也在密切关注全球形势的变动情况。

注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单	无
日期	2019年8月20日